

时间	2025年1月21日 18:00
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、陈卓璜
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、公司 2024 年度业绩预告情况</p> <p>公司2024年经营成绩表现不好，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为-20,000万元至-17,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元至-17,000万元。自2010年上市以来首次亏损。</p> <p>公司业绩较去年同期变动的主要原因如下：</p> <p>1、经营层面</p> <p>主要受 FCBGA 封装基板业务费用投入、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损影响。具体如下：</p> <p>FCBGA封装基板项目仍处于投入期，成本费用投入较大，对公司2024年净利润形成较大影响，其2024年整体费用投入（包括人工、折旧、动力和材料费用）超7.60亿元，同比增加超3.64亿元。</p> <p>宜兴硅谷聚焦高多层PCB板，因产品结构不佳及产能利用率不足导致2024年预计亏损约1.33亿元。</p> <p>广州兴科聚焦CSP封装基板业务，因产能利用率不足导致2024年预计亏损约0.70亿元。</p> <p>2024年，宜兴硅谷和广州兴科预计合计亏损2.03亿元，亏损增加约0.77亿元。</p> <p>2、其他影响</p> <p>（1）因参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司经营持续亏损，公司2024年度预计确认公允价值变动损失约6,000万元。</p> <p>（2）因部分子公司的经营情况发生变化，公司对其2024年底持有的资产情况进行减值测试，并计提减值准备。根据初步测算，公司2024年度预计计提资产减值约6,000万元。</p> <p>（3）公司前期对部分子公司确认的递延所得税资产，因经营情况发生变化，预计在税务允许抵扣的期限内无法取得足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异，对前期确认的递延所得税资产予以转回，公司2024年度预计转回递延所得税费用约7,600万元。</p>

以上事项合计影响税后净利润约1.8亿元。

注：以上均为财务部门初步核算数据，最终金额以审计结果为准。

二、公司所处行业情况介绍

根据 PrismaMark 报告,PCB 行业 2024 年逐季复苏,全年预计增长 5.8%、2025 年增长 6.1%左右。2023 年-2028 年 PCB 行业产值预测,从 736 亿美元增长到 911 亿美元,五年复合增长率为 5.6%。从下游行业看,表现最好的是 AI 和新能源相关,尤其服务器/数据中心领域的增长最快,预期 2025 年数据中心/服务器仍是表现最好的下游细分市场。从产品结构而言,2024 年表现最好的是高多层板和高阶 HDI 板,2025 年高多层板和高阶 HDI 板的市场仍会维持较高景气度,封装基板市场会持续复苏。

台系厂商欣兴电子 2024 年营收同比增长 11%、景硕科技同比增长 13.8%,仍处于逐步恢复的过程中,离 2022 年的高点仍有一定差距。从欣兴公开的信息看,其对 2025 年行业预期比较乐观,认为封装基板行业会全面回暖。

相比 2023 年,全行业资本开支下降约 10%,这反映了前几年的产能建设,以及随着市场不确定性的增加而采取的谨慎态度。

三、FCBGA封装基板项目的进展情况

截至目前,公司FCBGA封装基板项目的整体投资规模已超35亿,第一期第一阶段产能建设基本到位,目前已进入小批量生产阶段,工作聚焦市场拓展和量产爬坡。

截至目前,该项目已完成验厂客户数达到两位数,样品持续交付认证中,良率持续改善中,样品应用领域包括服务器、AI芯片、智能驾驶、交换机晶片、网卡、通信产品等,具体应用视终端客户产品应用而定。

公司FCBGA封装基板项目预计2025年小批量订单会逐步上量,公司一方面将持续投入资源提升技术能力、工艺能力和产品良率,通过工厂层面的良好运营表现增强客户信心,为更多打样机会和量产订单的导入打下坚实的基础;另一方面,将加大市场拓展力度,在全力拓展国内客户的基础上,持续攻坚海外大客户,争取持续的审厂、打样和量产机会,努力把握海外客户供应链本土化的机会,争取2025年完成海外客户产品认证,进入小批量订单供应阶段。同时,工厂层面加强成本管控,优化资源配置,持续降本减负。

四、公司CSP封装基板业务情况介绍

2024年度公司CSP封装基板业务产值保持稳步上升，主要系主要存储客户的份额提升和产品结构优化。

珠海CSP封装基板项目亏损主要是产能利用率未如预期提升，全年综合产能利用率较低，但第四季度订单已逐步回暖。公司将采取措施保证稳定的交付和质量表现，争取持续提升大客户订单份额。公司将在聚焦存储、射频双主产品线的基础上，扩充AP、车载产品线，不断优化产品结构，提升高附加值产品比例，提升盈利能力；同时，不断提升自身工艺水平和交付能力，提高客户粘性，并加大市场开拓力度，争取导入更多的客户和产品订单。

五、公司半导体测试板业务情况介绍

公司半导体测试板采用研发、设计、制造、表面贴装和销售的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程，产品类型包括探针卡、测试负载板、老化板、转接板。

2024年公司半导体测试板业务产能利用率持续提高，产品良率、准交率和客户满意度持续提升，30层及以上高阶产品的占比持续增长，季度间接单规模、大客户份额占比和产值规模持续增长，营收及盈利能力持续创新高，未来有望为公司收入增长继续贡献力量。

六、北京兴斐电子有限公司经营情况介绍

北京兴斐产品类别包括HDI板、类载板、FCCSP基板和采用BT材质的FCBGA基板，产品应用领域包括高端手机主板和副板、光模块等。2024年度整体经营表现稳定，利润表现较好。未来拟增加面向AI服务器领域如加速卡、高端光模块等产品的产能，把握AI时代的行业机会。

七、公司传统PCB业务情况介绍

公司传统PCB业务包括样板快件、小批量板和多层板，2024年PCB业务收入表现维持稳定，业务基本盘未发生变化。

宜兴硅谷高PCB多层板业务亏损主要还是产品结构不佳，我们前期以国内客户为主，叠加产能利用率不足，整体经营表现不好，对公司盈利能力造成拖累，其目前主要聚焦两方面工作：其一是导入数字化管理系统，持续提升管理效率；其二是降本增效提质，目前整体良率提升、交付改善、成本逐步下降、订单持续导入。未来宜兴硅谷除聚焦通信市场外，还

会投入较大的资源和力量聚焦服务器、交换机、计算和存储赛道，重点提升产品结构、良率和交付表现，努力实现经营改善和进一步减亏的目标。

八、公司在AI领域的布局

公司在AI领域的布局包括PCB和半导体业务。PCB 领域宜兴硅谷投入较大的资源和力量聚焦服务器、交换机、计算和存储赛道；北京兴斐已启动产线升级改造项目，旨在增加面向AI服务器领域如加速卡、高端光模块等产品的HDI和类载板产能。半导体领域的IC封装基板为芯片封装的基础原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域；ATE半导体测试板包括探针卡、测试负载板、老化板等产品，可满足芯片从晶圆制造至封装之后的全流程测试需求。

九、怎么看待玻璃基板的发展

公司在玻璃基板的投入已经差不多两年时间，如果未来玻璃基板能够成为一种行业趋势，我们可能会是先行者之一，但玻璃基板对ABF载板并不是一个替代的概念，它只是把核心的CORE层从树脂变成玻璃，还是ABF增层的工艺，对我们现有的ABF业务而言，并不会造成冲击。但在可预见的未来两到三年，我们预计玻璃基板并不会成为一种潮流，核心在它整个产业链的配套，特别是终端这块配套还不成熟，目前还处于探索阶段。

十、公司未来发展方向

公司仍坚定加码数字化转型和高端封装基板战略。

传统PCB领域的数字化转型稳步推进，通过数字化转型实现提质降本增效，在质量、技术、交期等环节提升竞争力，实现平稳增长。

半导体业务方面，CSP封装基板将在现有产能满产后启动扩产计划；FCBGA封装基板项目客户认证、良率提升及量产导入稳步推进。

附件清单

无

日期

2025年1月21日